(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/304

(11) 공개번호 특1997-0077275
(43) 공개일자 1997년12월12일

(21) 출원번호 특1996-0017393
(22) 출원일자 1996년05월22일

(71) 출원인 현대전자산업 주식회사 김주용
경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1 (우 : 467-860)
(72) 발명자 박현
전라남도 목포시 용해동 776번지 6호
(74) 대리인 최홍순

심사청구 : 없음

(54) 웨이퍼 백그라인딩 공정시의 실리콘 파티클 제거방법

요약

본 발명은 백 그라인딩시 발생되는 파티클의 제거를 위한 침전수로써 알콜을 사용하므로써, 경제적이면서 공정시간을 단축시킬 수 있고, 소자의 신뢰성도 향상시킬 수 있는 웨이퍼의 백 그라인딩 공정시의 실리콘 파티클 제거방법을 제공하는데 목적이 있다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 실리콘 웨이퍼의 백 그라인딩 공정에 있어서, 상기 공정에 발생되는 파티클을 제거하기 위한 침전기의 제거수로써 알콜이 사용되는 것을 특징으로 한다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

웨이퍼 백그라이인딩 공정시의 실리콘 파티클 제거방법

[도면의 간단한 설명]

제2도는 일반적인 웨이퍼 백 그라인더의 외부구성도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

실리콘 웨이퍼의 백 그라인딩 공정에 있어서, 상기 공정에서 발생되는 파티클을 제거하기 위한 침전기의 제거수로써 알콜이 사용되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼의 백 그라인딩 공정시의 실리콘 파티를 제거방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면2

